

CHIPFILL

Oprava komunikací





RYCHLÉ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ CHIPFILL®

Je speciálně vyvinutý termoplast pro opravu defektů povrchů komunikací o velikosti do průměru cca 20 cm. Minimalizuje riziko další degradace povrchu. Horký termoplast vteče i do nejjemnějších prasklin. Doba potřebná k opravě do otevření provozu je cca 20 min.

JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ MANIPULACE

Za horka aplikovaný termoplast vykazuje lepší přilnutí k vozovce oproti způsobům oprav prováděným za studena. Při zahřátí se vytváří termoplastická vazba s asfaltem. ChipFill® je efektivní dočasné řešení opravy, které minimalizuje další degradaci povrchu. Účinně zamezuje pronikání vody do trhlin. Při práci s materiálem ChipFill® nejsou zapotřebí žádné těžké mechanismy. Materiál je lehký a práce se dá provést pomocí ručního nářadí.

APLIKACE CHIPFILL®

Je velmi jednoduše aplikovatelný a jeho použití je snadné po celý rok. K vyčištění díry vystačí tvrdý smeták, k přehřátí díry (vysušení) a k aplikaci postačí ruční plynový hořák. Po prohřátí výtlučku se rozprostře materiál do vrstvy o tloušťce max. 15 mm a rozežře se. V případě, že je zapotřebí další vrstva, materiál opětovně rozprostřeme a roztavíme. Maximální výška by neměla přesahovat 45 mm. Vrstvy na sebe aplikujeme za tepla. Na finální vrstvu sypeme za horka protismykovou drť.



1. Důkladné vymetení (vyfoukání) nečistot z opravovaného výmolu či prasklin.



2. Odstranění vlhkosti zahřátím pomocí hořáku, tak aby bylo aplikované místo zcela suché.



3. Rozproštění vrstvy hmoty ChipFill® v tenké vrstvě (max. 15 mm).



4. Důkladně materiál rozežřejte pomocí hořáku. Aplikujte další vrstvu, je-li to zapotřebí. Finální horkou vrstvu posypte zdrsňujícím materiálem.

